

# 雪球访谈

存储芯片巨头加码HBM赛道，释放了哪些信号？

2023年11月30日

**雪球**

聪明的投资者都在这里

## 免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

## 版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



# 访谈嘉宾



建idea V 雪球实盘大赛参赛选手

## 访谈简介

近日，随着两大存储芯片巨头：三星、SK海力士拟将HBM产量提高至2.5倍的消息曝出，HBM概念股受到市场关注，一跃成为半导体产业链的新宠。三星显示（Samsung Display）天安厂区内部分建筑及设备，其计划在天安厂建立一条新封装线，用于大规模生产HBM。公司已花费105亿韩元购买上述建筑和设备等，预计追加投资7000亿-1万亿韩元。SK海力士预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗，并决定在2024年预留约10万亿韩元的设施资本支出，相较23年6-7万亿韩元的预计设施投资相比，增幅高达43%-67%，超出市场预期。

天风证券指出，HBM作为目前唯一满足AI高性能计算要求的量产存储方案，已经受到了不少投资者的追捧，虽然它的市场份额还很低，但未来两年它的需求量也将会呈现爆发式的增长。与此同时，据Omdia数据显示，2023-2027年，DRAM市场收入年增长率预计为21%，而HBM市场预计将提高至52%，HBM在DRAM市场收入份额中预计将超过10%，到2027年将接近20%。

在此消息驱动下，A股以赛腾股份、太极实业等为首的HBM概念相关个股也在近期掀起涨停潮。受益于AI大模型高算力需求的推动，HBM或迎来新一轮成长机遇，而国产厂商也有望实现弯道超车。那么，如何看看待后续HBM以及半导体

芯片全产业链的投资机会？本期我们邀请到建idea做客雪球访谈，跟大家共同探讨，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：太极实业(SH600667),赛腾股份(SH603283)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 187爱穿比基尼:

对 @建idea 说: 请问老师HBM存储国内有哪些厂家有布局呢, 想咱们熟知的长鑫和长江存储用的是此类技术吗?

[答] 建idea:

长江存储自身没有涉及HBM, 但是母公司的下属公司万润科技有涉及。其他的还有:

香农芯创: 海力士企业级业务核心代理商, 并联手海力士成立子公司合作发力SSD业务(香农芯创占35%), 下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等。

华海诚科: 存储芯片最强预期差, HBM上游封装原材料GMC国内唯一上市公司, 已经通过客户验证进入送样阶段, 下半年产品放量, 突破封锁。GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料

雅克科技: SK海力士的核心供应商, HBM核心标的。22年海力士收入占比50%, 也是合肥长鑫核心供应商。

深科技: 国产存储封测龙头, 是国产 DRAM 龙头合肥长鑫的主力封测供应商

太极实业: 与海力士成立合资公司海太半导体, 具备高端 DRAM 封测能力。太极实业年报中披露公司拥有国内唯一16层 DRAM 高堆叠技术储备, 因为海太半导体技术来自海力士, 目前提供DRAM封装技术, 后续将有望承接HBM3封装订单。

[问] 愚旦:

对 @建idea 说: HBM国产替代的优势在哪里, 现在国内有厂商有这种技术吗? HBM更应该注重投资材料端, 还是什么端?

[答] 建idea:

目前的HBM只有海力士, 三星, 美光能够实现。目前国内的企业参与制程的某些材料和环节。我对于HBM的看法是, 核心价值还是在制造, 但是有可能打开如封装原材料等特殊材料的成长空间。

[问] 香波地海:

对@建idea 说: 建哥, HBM存储设备都有哪些?

[答] 建idea:

HMB技术的原理, 是在主机的内存中留出一块缓存区专门供SSD使用。这部分区域只占用内存小部分空间(128MB以内), 内存保留充足的空间协调完成CPU与硬盘之间的数据交换。对CPU和整机性能没有任何影响。

这个应用创新, 用于内存和显卡之间的交换就显得特别有价值, 因为直接可以提高处理器信号流量, 对处理器效率提升极大。

[问] 柿柿如意XLJ:

对@建idea 说: 对国内厂家影响如何, 对哪家影响最大?

[答] 建idea:

按照相关研报和资料来看, HBM产业链主要由IP、上游材料、晶粒设计制造、晶片制造、封装与测试等五大环节组成。由于国际大厂均采用IDM模式, 芯片的设计、制造和封测都由大厂一手包办, 国内厂商主要处于上游设备和材料供应环节。

设备端: TSV和晶圆级封装需求增长。由于独特的3D堆叠结构, HBM芯片为上游设备带来了新的增量: 前道环节, HBM需要通过TSV来进行垂直方向连接, 增加了TSV刻蚀设备需求; 中段环节, HBM带来了更多的晶圆级封装设备需求; 后道环节, HBM的多芯片堆叠带来die bond设备和测试设备需求增长。

材料端: HBM的独特性主要体现在堆叠与互联上。对于制造材料: HBM核心之一在于堆叠, HBM3更是实现了12层核心Die的堆叠, 多层堆叠对于制造材料尤其是前驱体的用量成倍提升; 对于封装材料: HBM将带动TSV和晶圆级封装需求增长, 而且对封装高度、散热性能提出更高要求

[问] 思而学投资:

对@建idea 说: HBM难点在哪里? 国内 有哪些公司可以做或者有机会做, 谢谢

[答] 建idea:

难点当然在于这是一种新工艺，会涉及到工艺改变，设备的更新。所以目前只有海力士，三星，美光可以完成制造制程。对于国内企业来说，机会在于围绕大厂展开关键材料和设备的供应。具体公司可以关注万润科技，香农芯创，华海诚科，雅克科技，深科技，太极实业等。

[问] 思而学投资:

对@建idea 说：HBM市场空间预期有多少？量X价

[答] 建idea:

市场预测的非常大。受高算力需求的带动，TrendForce集邦咨询预测，2024年全球HBM的位元供给有望增长105%。到2024年，HBM的市场规模有望达到89亿美元，同比增长127%；预计到2025年将突破100亿美元。

[问] 香波地海:

对@建idea 说：一级市场有没有比较知名的存储芯片设备企业？赛腾算实锤供应的三星的企业，不过具体是哪种设备了解吗？

[答] 建idea:

一份近期赛腾的调研给你参考，关于HBM：optima晶圆端最重要客户是三星，索尼、台积电也看重，硅片端是SK、SMICO等，国内基本上全覆盖。三星15台HBM量测订单，最近几个月下单，2024年6月之前交付，单价200万美金，一片一片贴上去的晶圆，洗薄后需要量测，主要做这个，和之前的量测产品有些定制化差异。8k片HBM扩产对应1台该量测设备需求，2024年下半年预计三星还有15台需求。海力士还在接触，海力士还没有预期，预计可以很快进去。

[问] 阿勇热干面:

对@建idea 说：老师好，HMB这个概念我仔细研究了一下，它确实是可以推动算力的进程，尤其是国产化方向，但是国内半导体进展和海外整体差距还是较大的，另

外A股市场注重博弈，尤其是这种新的概念，那么这个产业到底进展到什么程度了，是不是可以形成真正的产业趋势呢？请老师给予解惑，谢谢！

[答] 建idea：

产业已经实现了理论设计，流片完成，送样认可。马上就要开始量产爬坡了。所以这个阶段，肯定是出货未动，设备先行，市场也非常敏感的抓住了核心设备股\$赛腾股份(SH603283)\$。HBM是可以形成产业的，这个前景已经是非常确定了。

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

# 没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里